

본 연구는 부산대학교 정밀정형 및 금형가공 연구센터를 통한 한국과학재단 우수연구센터 지원금에 의한 것입니다.

## 레이저빔 반사 화상을 이용한 연마면 거칠기 측정법에 관한 연구

Yun-Feng Shen\*, 임한석\*\*, 김화영\*\*\*, 안종환\*\*\*

### A Study on Roughness Measurement of Polished Surfaces Using Reflected Laser Beam Image

Yun-Feng Shen\*, Han-Seok Lim\*\*, Hwa-Young Kim\*\*\*, Jung-Hwan Ahn\*\*\*

#### ABSTRACT

This paper presents the principle and experimental results of a non-contact surface roughness measurement by means of screen projected pattern of laser beam reflected from a polished surface.

In the reflected laser beam pattern especially from a fine surface like ground or polished one, light intensity varies from the center of the image to its boundary as the Gaussian distribution. The standard deviation of a light intensity distribution is assumed to be a good non-contact estimator for measuring the surface roughness, because the light reflectivity is known to be well related with the surface roughness. This method doesn't need to discriminate between the specularly reflected light and the diffusely reflected one, whereas the scattered laser intensity method must do. Nor it needs to adjust the change of light intensity caused by environmental lights or specimen materials.

Reflected laser beam pattern narrowly spreads out in the vertical direction to tiny scratches on the polished surface due to abrasives. The deeper the scratch the more the dispersion, which means the rougher surface. The standard deviation of the pattern is nearly in proportion to the surface roughness. Measurement errors by this method are shown to be below 10 percent compared with those obtained by a common contact method. The inclination of measuring unit from the normal axis causes the measurement errors up to 10 percent for an angle of 4 degree. Therefore the proposed method can be used as an on-the-machine quick roughness estimator within 10 percent measurement error.

**Key Words :** surface roughness(표면 거칠기), polished surface(연마표면), Gaussian surface(정규분포표면), scattered lights(산란광), light intensity(광강도), specularly reflected light(정반사광), diffusely reflected light(난반사광), standard deviation(표준편차)

#### 1. 서 론

연마공정은 제품 제작의 마무리 단계 작업으로

연마공정에서의 정밀도는 해당 제품의 질을 결정하는 중요한 요인이 된다. 연마가공 후 표면 상태의

\* 부산대학교 대학원

\*\* 부산대학교 기계기술연구소

\*\*\* 부산대학교 기계공학부

품위를 평가하는 표면 거칠기 측정은 전통적으로 촉침식 표면조도 측정기를 사용해 왔으며 아직까지 촉침식이 표준적인 방법으로 인정되고 있다.<sup>(1)</sup> 촉침식은 고정도 측정이 가능한 반면 측정 시간이 길고 생산라인에서의 기상(on-the-machine) 또는 가공 중 측정이 부적합하다는 단점을 가지고 있다.

표면 거칠기의 비접촉 측정에는 광절단법, 광촉침법 등 표면의 미세형상 자체를 측정하는 비매개 변수법<sup>(2~4)</sup>과 정반사광을 이용한 방법, 난반사광을 이용하는 방법, TIS(Total Integrated Scatter) 방법, 산란각 분포를 이용하는 방법 등 특정 거칠기 변수만 측정하는 매개변수법<sup>(5~12)</sup>이 있다. 기상 또는 가공중 측정을 위해서는 빠른 측정이 필요하므로 일반적으로 매개변수법으로 분류되는 방법이 바람직하며 그 중에서도 측정장치 구성의 간편성이나 효율성을 고려할 때 광산란법이 가장 적절한 방법으로 평가되고 있다.<sup>(6)</sup>

가공 자동화와 생산성 향상을 위해 절삭가공<sup>(13~14)</sup>, 그리고 연삭가공<sup>(15~16)</sup>에서는 가공물을 가공기에서 이탈시키지 않고 가공물 표면 거칠기를 측정할 수 있는 기상 계측의 필요성이 꾸준히 제기되어 왔으며 많은 연구가 계속되어 왔다. 금형연마표면에 대한 표면 거칠기 평가는 가공중 속련공이 표준시편을 사용하여 거칠기 정도를 비교 판단하고 있으며 연마가공중 금형 표면의 표면 거칠기를 정량화할 수 없는 실정이다. 표면 거칠기를 정량화하기 위해서는 금형을 연마기에서 이탈시켜 측정실에서 측정해야 하며 대형 금형의 경우는 측정실에서도 측정하기 어려운 실정이다. 따라서 본 연구에서는 금형 연마 가공물을 연마기에서 이탈시키지 않고 연마표면 거칠기를 측정할 수 있는 비접촉 측정법을 연구하고자 한다.

광산란을 이용한 비접촉식 표면 거칠기 측정법에 관한 연구는 여러 연구자들에 의해 많이 수행되어 왔다.<sup>(5~16)</sup> 이전 연구들은 대부분 산란광의 강도를 측정하는 방법을 사용하고 있다. 이들 방법은 표면상태에 따른 편차가 크고 측정가능 영역이 한정되 광학계가 복잡해지는 단점을 갖고 있다. 그리고 측정재질의 반사율, 색상, 외부광원의 영향을 많이 받으며 산란광 강도를 측정하기 위해 산란된 광이 렌즈의 수광각 범위를 벗어날 경우 산란광의 전체 정보에 대한 획득이 불가능하다.<sup>(13~17)</sup>

본 연구에서 이와 같은 문제점을 해결하기 위하-

여 반사광의 스크린 투영패턴을 이용한 표면 거칠기 측정법을 제안하였는데 렌즈 대신 스크린을 사용하여 스크린에 맺힌 산란광의 분포 패턴을 구하기 때문에 구조가 간단하고 산란광 전체 정보의 획득이 가능하였으며 표면 거칠기에 따른 산란광 분포패턴의 직접관찰이 가능하다. 본 연구에서는 표면에서 반사된 레이저빔을 스크린에 투영시켜 환경 변화에 따른 변동을 억제하면서 산란광의 분포 정보를 획득하고, 이를 분석하여 연마면의 표면 거칠기를 측정하는 PLBP(Projected Laser Beam Pattern)법을 개발하였다.

## 2. 측정원리

Fig. 1은 본 연구에서 제안한 산란광의 스크린 투영패턴을 이용한 표면 거칠기 측정법의 원리를 설명하고 있다. 레이저 다이오드에서 출력된 평행 광은 일정한 경사각( $\theta$ )으로 측정 표면에 입사된다. 입사된 레이저광은 피측정물의 표면에서 산란하게 되는데, 산란된 빛은 CCD 카메라의 전방에 설치된 스크린에 거칠기 정보를 가지는 특정의 패턴을 형성하게 된다. 이 패턴 정보를 CCD 카메라로 읽어들여 거칠기 측정 정보로 사용한다. 표면 거칠기가 작을수록 분포곡선은 C→A로 바뀐다. 광량분포곡선에 대한 평균( $m_x$ ), 분산( $V_x$ ), 표준편차( $\sigma_x$ )는 다음 식과 같다.

$$m_x = \frac{\sum(x_i \times g_i)}{\sum g_i} \quad (1)$$

$$V_x = \frac{(\sum(x_i - m_x)^2 \times g_i)}{\sum g_i}, \sigma_x = \sqrt{V_x} \quad (2)$$

여기서  $x_i$ 는 화소(pixel) i의 위치이고,  $g_i$ 는 해당 화소의 밝기를 나타내는 그레이 레벨(gray level)이다.

레이저빔의 반사화상을 취득하는 방법은 Fig. 2와 같이 수직형과 경사형의 2가지가 가능하다. Fig. 2(a)의 수직형은 측정장치를 측정면의 범위에 위치에 놓이게 할 수 있는 장점을 가지고 있지만 측정면과 측정장치 사이의 거리를 일정하게 유지하기 어려운 단점을 가지고 있다. Fig. 2(b)의 경사형은 반대로 측정 거리를 일정하게 유지할 수 있는 장점을 가지고 있지만 측정면이 기울어져 있을 때 측정장치의 자세를 조절하지 않으면 오차가

거지는 단점을 가지고 있다. 본 연구에서는 1차적으로 평면 연마시편에 한정하여 가공 면과 측정장치 사이의 거리를 일정하게 유지하기 쉬운 경사형을 선택하였다.

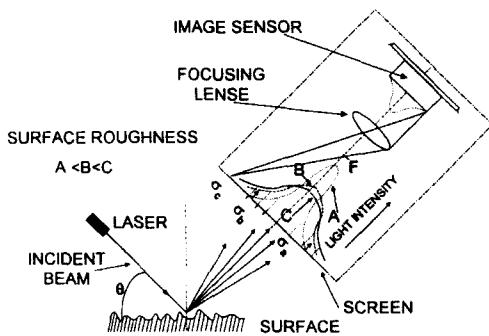


Fig. 1 Principle of surface roughness measurement using scattered laser beam pattern

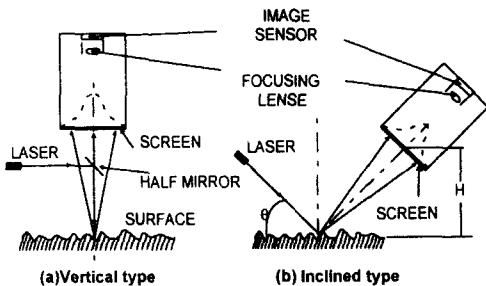


Fig. 2 Two types acquiring laser beam pattern

Fig. 3은 측정면과 측정장치 사이의 거리를 일정하게 유지하는 방법을 설명하는 그림이다. 우선 측정기에 대해 수직으로 시편을 설치하고 그림과 같이 Z축을 구동하면, 측정장치와 측정면 사이의 거리가 변화됨에 따라 스크린에 맺힌 상의 위치가 변화된다. 거리의 변화( $\Delta H$ )에 따른 화상 위치의 변화( $\Delta L$ )는 식(3)과 같다.

$$\Delta L = \frac{\sin 2\theta}{\cos \theta} \Delta H = (2 \sin \theta) \Delta H \quad (3)$$

광량분포곡선은 높이 변화에 따라서 스크린 상에서의 위치가 변화된다. 식(3)에서  $\theta$ 가 일정하다면  $\Delta L \propto \Delta H$ 이므로  $\Delta H=0$ 로 하기 위해서  $\Delta L=0$  되도록 하면 된다. 이것을 높이 맞춤이라하며 이를 자동으로 수행하기 위해 1)CCD 카메라에 맺힌 산란

광 패턴으로부터 스크린의 중심을 통과한 한 라인 상에 있는 광량을 읽어들여서 2)평균치( $m_x$ )를 구한 다음  $m_x$ 가 스크린 중심의 좌표 치와 일치하도록 측정장치를 아래, 위로 이동시킨다.

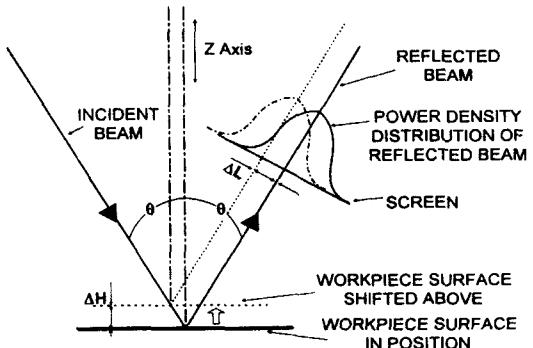


Fig. 3 Principle of measurement height adjustment

### 3. 실험장치의 구성

전체 실험장치의 구성은 Fig. 4와 같이 PC, 측정부, XY 테이블, 화상입력장치(image grabber), 반도체레이저 발광장치 등으로 구성되었다. CCD 카메라에 맺힌 화상은 화상입력장치를 통하여 PC에서 읽어들여 데이터 처리를 행한다. 화상의 각 화소는 화상입력장치에서 8 bit로 A/D변환되어 0~255사이의 그레이레벨(gray level)로 입력되게 된다.

Fig. 5는 스크린 투영패턴을 이용한 측정장치 도이다. 측정장치의 설계에서 레이저빔의 입사각은 중요한 설계 파라메터 중 하나이다. 입사각이 너무 작으면 측정면과 측정장치 사이의 거리 맞춤이 어렵고 입사각이 큰 경우는 측정장치가 커진다는 단점이 있다. 본 연구에서는 예비실험을 통해 레이저빔의 입사각을  $30^\circ$ 로 하였으며 거울면을 사용하여 스크린에 맺힌 상의 방향을 바꾸어 CCD 카메라에 잡히게 하므로 측정장치를 소형화하였다. 스크린의 중심과 시편과의 거리는 30mm가 되도록 측정장치를 설계하였다.

실험에 사용된 CCD 카메라의 사양은 Table 1과 같다. 레이저 발광기로 파장  $\lambda=0.6328\mu\text{m}$ , 출력 4mW의 레이저 다이오드를 사용하였다. 레이저 다

이오드는 레이저 발진을 개시하는 임계전류나 광출력의 편차가 있기 때문에 일정한 전류를 흘려도 일정한 광출력을 얻을 수 없으며 온도에 의해서도 광출력이 변동한다. 따라서 본 연구에서는 APC(Automatic Power Control)회로를 사용하여 다이오드의 광출력을 일정하게 제어 하도록 하였다. 또한 레이저 다이오드의 광출구쪽에 직경 1mm 구멍의 차단판을 설치하여 측정영역을 직경 1mm로 제한하였다.<sup>(14)</sup>

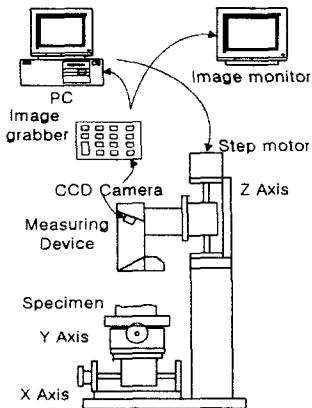


Fig. 4 Schematic diagram of experimental setup

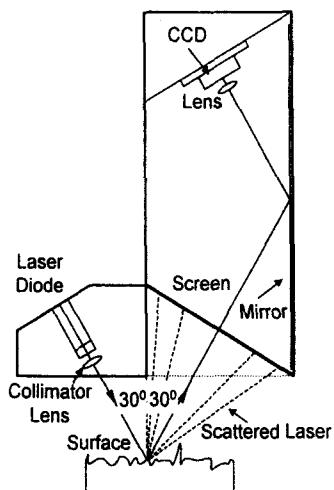


Fig. 5 Measuring device with pattern projected screen and mirror

Table 1. Specification of CCD camera(made by SAMSUNG ELECTRIC CO.,LTD)

Model	BCS-724A
Area(μm)	6.4(L) × 7.5(H)
Pixels	811(L) × 507(H)
Resolution	Horizontal:580TV LINES Vertical :350TV LINES

외부광원의 영향을 차단하고 레이저광의 반사에 의해서만 맷힌 화상데이터를 분석하기 위해 레이저 다이오드를 ON/OFF하여 ON상태의 그레이 레벨에서 OFF상태의 그레이 레벨을 뺀 것을 화상 입력데이터로 하였다.

#### 4. 실험결과 및 고찰

##### 4.1 거칠기 표준시편을 이용한 시스템 평가

본 연구에서 사용된 비교용 표준시편의 규격은 일본 규격인 JIS B 0659 시편이고,  $R_{max}(\mu\text{m})$ 로 각각 0.2-S, 0.4-S, 0.8-S, 1.6-S, 3.2-S로 총 5가지이다. 본 연구에서는 자유입자에 의한 연마가공을 래핑가공이라고 정의하였고, 고정입자에 의한 연마가공을 연마가공이라고 정의하였다. 표준시편중에서  $R_{max}$ 가 0.2~0.8인 시편은 래핑가공면의 시편이고  $R_{max}$ 가 1.6~3.2인 시편은 연마가공면의 시편이다.

표준시편의 측정화상과 현미경 사진은 Fig. 6과 같다. Fig. 6에서  $R_{max}$  0.2~0.8인 시편은 래핑면이기에 표면에 뚜렷한 스크래치(scratch) 방향이 없고 표면이 웬덤한 특성을 가지고 있다.  $R_{max}$  1.6~3.2인 시편은 연마면이기에 뚜렷한 스크래치 방향이 있고 면의 특성이 일정한 방향성(directivity)을 가지고 있음을 알 수 있다. 반사광의 분포패턴은 스크래치의 영향을 많이 받으며 스크래치 방향에 수직되는 방향으로 많이 퍼진다. 이러한 특성은 측정화상에서 산란광 패턴의 전반적인 형태를 통해서도 알 수 있다.

Fig. 6의 측정화상 패턴은 시편 방향을 잘 맞추었을 경우이고 패턴을 일반화하면 Fig. 7(a)과 같이 표현된다. 그림에서 Y(primary direction)는 패턴의 장축에 해당되는 선이고 X(secondar direction)는 패턴의 단축에 해당되는 선이다. 두 방향으로 나누어서 시편 거칠기에 따른 표준편차를

그리면 Fig. 7(b), Fig. 7(c)와 같다. Fig. 7(b)는 주방향에서의 거칠기 값과 표준편차의 상관관계이고 Fig. 7(c)는 부방향에서의 거칠기 값과 표준편차의 상관관계이다. 주방향에서의 표준편차가 부방향에서 구한 표준편차보다 거칠기와 상관관계가 높음을 알 수 있다. 본 연구에서는 주방향의 광량 분포 표준편차를 연마면 거칠기 측정을 위한 파라미터로 사용한다.

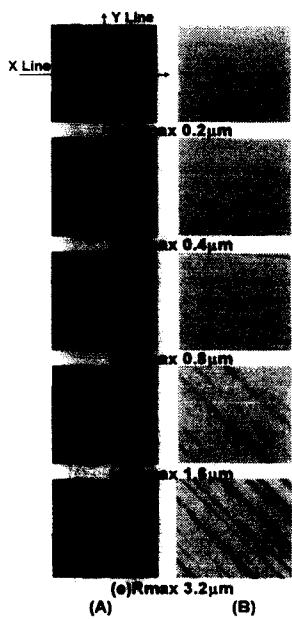


Fig. 6 Measured Laser Beam Pattern(A) and Microscopic Surface of Specimen(B)

Fig. 7(b)으로부터 래핑면과 연마면에 대해 표면 거칠기와 표준편자는 일정한 비례관계를 가지며 같은 연마면이라도 자유 입자와 고정 입자에 의해 가공된 면의 특성이 다름을 알 수 있다. Fig. (b)로 부터 거칠기와 표준편차의 상관관계식을 구하기 위해 최소자승법을 이용하여 직선 근사한 식이 (4), (5)식이다.

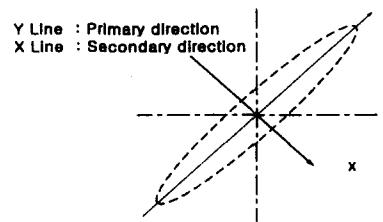
$$\text{래핑면일 때 } \sigma_y = \frac{R_{\max} - 22.95}{57.28} \quad (4)$$

$$\text{연마면일 때 } \sigma_y = \frac{R_{\max} - 67.32}{1.81} \quad (5)$$

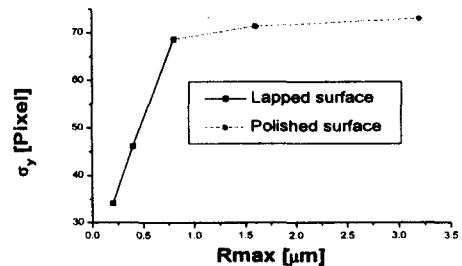
따라서 CCD카메라에 잡힌 산란광의 광량 분포로부터 표준편차를 구한 뒤 식(4), (5)를 이용하여

연마면의 표면 거칠기를 간접적으로 측정할 수 있다.

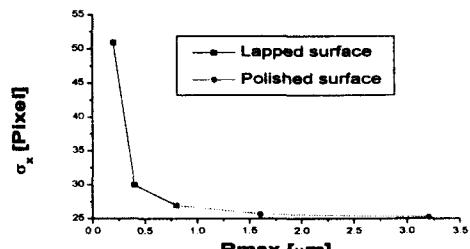
Table 2는 식(4), 식(5)로 학습시킨(교정한) 테이터를 이용하여 본 연구에서 제안한 방법인 PLBP법으로 측정한 값과 접촉식 표면조도 측정기 SV-400(made by Mitutoyo)으로 측정한 값을 비교한 표이다. PLBP법에서는 시편을 10회 측정하여 얻어진 광량분포의 표준편차를 식(4)와 식(5)에 대입하여 거칠기 값을 측정하였다. 표준시편에 대해서 PLBP법의 측정오차는 8%이내이고 재현성이 우수함을 알 수 있다.



(a) Two principal directions of reflected laser beam pattern



(b) Primary direction



(c) Secondary direction

Fig. 7 Standard deviation of light intensity distribution according to primary(b) and secondary direction(c)

#### 4.2 가공 시편의 거칠기 측정 실험

실제 연마면에 대한 평가실험을 하기 위해 #100, #200, #400, #800인 CBN수돌로 각각 20회씩 가공을 하여 연마면을 얻었다. 접촉식 측정기 SV-400으로 측정한 값을 기준 값으로 하여 PLBP으로 측정한 값을 비교하였다. Table 3은 기준치와 측정치의 비교표이다. 가공시편에 적용하였을 때 거칠기 측정치와 기준치의 상대오차는 8% 범위 이내이다.

Table 2. Surface roughness measurements for standard specimen

Specimen	1	2	3	4	5
SV-400( $\mu\text{m}$ ) (Reference)	0.2	0.4	0.8	1.6	3.2
PLBP( $\mu\text{m}$ )	0.196	0.406	0.735	1.696	3.171
Error(%)	2	1.5	7.8	6	0.9

\*SV-400 : Mitutoyo surface roughness tester

PLBP : Proposed method in this study

Table 3. Surface roughness measurements for polished surface

Specimen	1	2	3
SV-400( $\mu\text{m}$ ) (Reference)	0.6	0.7	1.1
PLBP( $\mu\text{m}$ )	0.66	0.65	1.19
Error(%)	10	7.1	8.0

#### 4.3 외부 환경의 영향에 대한 평가

실제 기상 측정을 위해서는 여러 작업환경 등에 대해 강인하여야 한다. 이를 위해 외부 광원의 영향, 높이 변동의 영향, 절삭유의 영향 등에 대하여 평가를 하였다.

외부 광원의 영향을 평가하기 위해 레이저 다이오드의 광출력을 일정하게 하여 암실과 일반 실내에서 측정을 해보았다. 입력된 화상의 주방향 광량 분포는 Fig. 8과 같다. 그림으로부터 암실에서 측

정한 그레이 레벨이 일반 실내에서 측정한 그레이 레벨보다 70정도 높지만 분포패턴은 거의 같다는 것을 확인할 수 있었다. 이는 광량분포의 표준편차를 매개변수로 하면 외부광원의 영향은 받지 않음을 나타낸다.

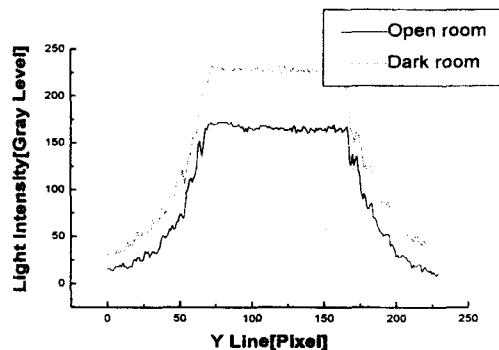


Fig. 8 Change of light intensity distribution due to external light

자동 높이 맞춤을 행한 후에도 높이는 일정한 오차를 가질 수 있다. 따라서 높이 변화에 따른 측정치의 변화를 알아보기 위해  $R_{max} 0.4\mu\text{m}$ 인 표준 시편에 대해 높이를  $0.1\text{mm}$ 씩 상하로  $0.5\text{mm}$ 까지 이동시키면서 거칠기 변화를 조사하였다. Fig. 9(a)는 높이 변화에 따른 화상의 위치 변화이고 Fig 9(b)는 높이 변화에 따른 거칠기 측정치이다. Fig 9(a)에서 알 수 있는 바와 같이 높이가 바뀌면 스크린 상에서 화상의 위치가 변화하나 화상이 스크린 중심에서 벗어날 뿐 화상의 크기 변화는 거의 없다. 따라서 매개변수인 표준편차는 스크린에서의 화상의 위치와 크게 관련이 없고, 거칠기 측정치는 높이 변동의 영향을 받지만 미세한 높이 변화에는 큰 영향을 받지 않음을 Fig. 9(b)로부터 알 수 있다.

절삭유의 영향을 조사하기 위하여 절삭유가 없는 상태와 절삭유가 있는 상태에서 표준 시편에 대해 측정을 해보았다. 절삭유 유무에 따른 거칠기 측정치의 상대 오차는 Fig. 10과 같다. Fig. 10에서 가공면에 절삭유가 있는 경우 측정치의 오차가 어느 정도 커짐을 알 수 있다. 따라서 본 장치를 기상 계측에 적용하여 정밀한 측정을 하기 위해서는 측정전 연마 표면에 있는 절삭유를 어느 정도

불어내고 나서 측정을 해야함을 알 수 있다.

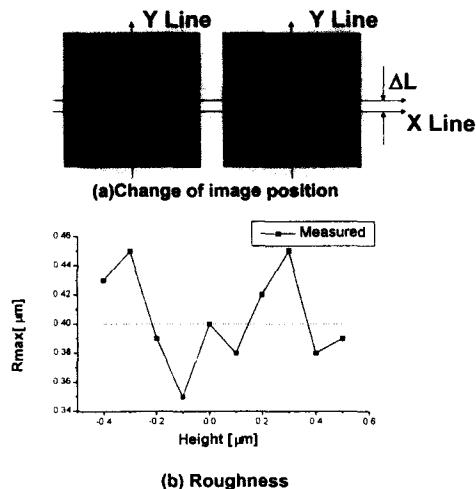


Fig. 9 Influence due to measurement height variations

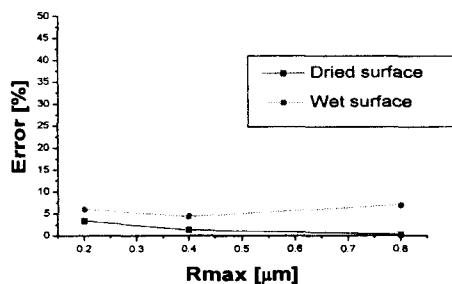


Fig. 10 Influence due to coolant

## 5. 결론

본 연구는 산란광의 스크린 투영패턴을 이용하면 거칠기 측정에 관한 기초적인 연구를 수행하였고 다음과 같은 결론을 얻을 수 있었다.

- 레이저빔의 반사화상을 이용한 비접촉 표면 거칠기 측정 시스템을 제작하였다.
- 반사광의 분포패턴은 측정면 스크래치의 방향과 수직인 방향(주방향)으로 넓게 퍼지며, 래핑면과 연마면에 따라 다른 분포패턴을 보였다.
- 주방향 광량분포의 표준편차와 표면 거칠기는 일정한 비례관계를 가지고, 측정오차가 10%이

내이므로 간이 측정용으로 유용하다.

- 화상 주방향 광량분포는 정규분포에 가깝고 표준편자는 주변 광원의 영향, 절삭유의 영향, 측정 높이 변화의 영향을 크게 받지 않는다.

## 참고문헌

- I. Sherrington and E. H. Smith, "Modern measurement techniques in surface metrology; part I: stylus instrument," Wear, Vol. 125, pp. 271-288, 1988.
- E. L. Church, "The measurement of surface texture and topography by differential light scattering," Wear, Vol. 57, pp. 93-105, 1979.
- Y. L. David, et al., "Surface profile measurement with a dual beam optical system," Applied Optics, Vol. 23, No. 5, pp. 746-751, 1984.
- O. Sasaki and Y. Fukuhara, "Surface profile measurement from intensity of diffracted light using the phase retrieval method," Applied Optics, Vol. 24, No. 16, pp. 2696-2700, 1985.
- 塙田忠夫, 谷村吉久, 非接觸式による精密加工表面の性状評価. 日本精機學會, 1985.
- I. Sherrington and E.H. Smith, "Modern measurement techniques in surface metrology:part II:optical instruments," Wear, Vol. 125, pp. 36-42, 1988.
- P. Beckmann and A. Spizzichino, The scattering of electromagnetic waves form rough surfaces. Pergamon press, Oxford, 1963.
- L. H. Tanner, M. Fahoum, "A Study of the Surface Parameters of Ground and Lapped Metal Surfaces, Using Specular and Diffuse Reflection of Laser Light," Wear, Vol. 36, pp. 299-316, 1976.
- 日本機械學會, 光應用機械計測技術, 朝倉書店, 1985.
- 高井信勝, "レーザ光散乱による表面粗さ計測," 日本精密工學會誌, Vol. 64, No. 9, pp.1304-1307, 1998.
- T. V. Vorburger, et al., "Optical measurement of the roughness of sinusoidal surface," Wear, Vol. 109, pp.15-27, 1986.
- R. Brodmann and G. Thurn, "Roughness measurement of ground, turned and shot peened surfaces by the light scattering method," Wear, Vol. 109, pp. 1-13, 1986.

13. 森田 健二, 川久保洋一, “回折光を利用した鏡面加工表面粗さのインプロセス計測,” 日本精密工學會, 1988.
14. T. MIYOSHI and K.SAITO "Non-Contact Measurement of Ultra-Precision Diamond Turned Surface Roughness," Bull. of JSPE, Vol. 23, pp.182~188, 1989.
15. D.Y.YIM and S.W.KIM "Optical Roughness Measurement of Ground Surfaces by Light Scattering," Int. J. Mach. Tools Manufact. Vol.30, No.2, pp.283-289, 1990.
16. 홍성욱, 김현수, “기상 측정을 위한 광학적 표면 거칠기 측정센서 개발,” 한국정밀공학회지, 제 11권, 제6호, pp. 168-178, 1994.
17. Motoyoshi Hisaoka, “Development of Reflex Measurement on Surface Roughness by Scanning Vibration of Laser Beam,” Bull. of JSPE, Vol. 63, No. 3, pp. 410-414, 1997.